



## SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP223-5R4-A591

## Thin Film Planar Filters

### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

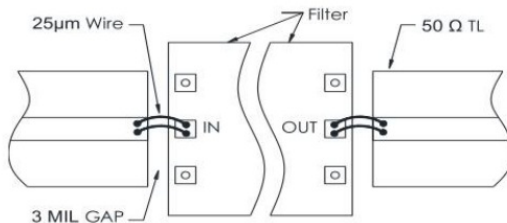
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

| 参数   | 最小            | 典型   | 最大   | 单位  |
|------|---------------|------|------|-----|
| 中心频率 |               | 22.3 |      | GHz |
| 工作频率 | 19.6          |      | 25.0 | GHz |
| 中心损耗 |               | 1.9  | 2.3  | dB  |
| 带内波动 |               | 1.1  | 1.5  | dB  |
| 回波损耗 | 12            | 15   |      | dB  |
| 带外抑制 | @DC-16.8GHz   | 60   | 65   | dBc |
|      | @27.2-46.0GHz | 60   | 65   | dBc |

### 环境要求

|        |                                           |     |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| 最大输入功率 | 35                                        | dBm |
| 工作温度   | $-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$  |     |
| 储存温度   | $-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$ |     |

### 推荐装配图



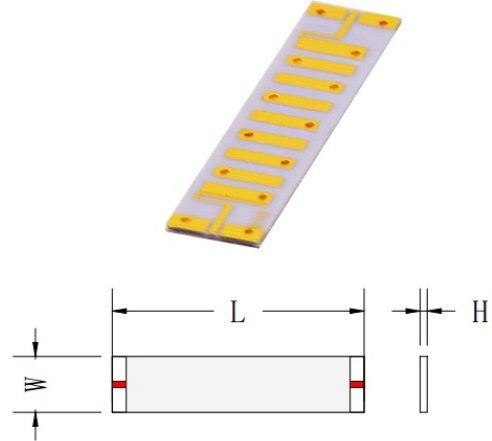
### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数( $6.7\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:

| 电路板Rogers5880, h: 0.254mm | 电路板Rogers5880, h: 0.127mm |
|---------------------------|---------------------------|
|                           |                           |

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

### 外形图



| 外形尺寸 | L   | W   | H     | 单位 |
|------|-----|-----|-------|----|
|      | 8.2 | 2.5 | 0.254 | mm |

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$

